

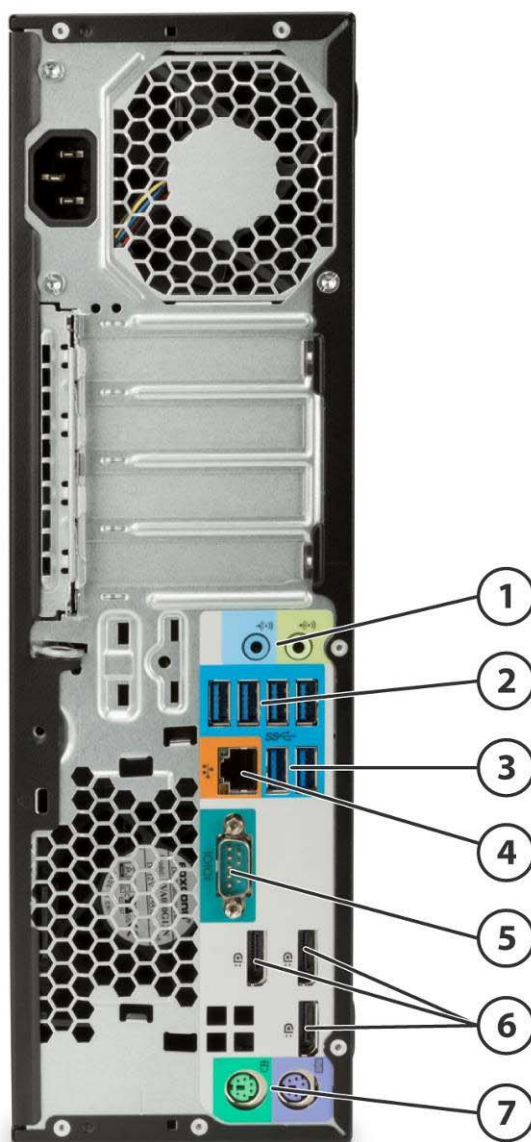
概要

HP Z240 SFF Workstation



1. 電源ボタン
2. スリムODDベイ
3. 外部/内蔵共有ベイ:3.5 インチ
4. SDカードリーダー (オプション)
5. USB 2.0/バッテリー充電ポート x 1
6. USB 2.0ポート x 1
7. USB 3.0 (青) ポート x 2
8. マイク/ヘッドフォン
9. ヘッドフォン

概要



1. オーディオライン入力 x1、オーディオライン出力 x1
2. USB 3.0 x 4
3. USB 3.0 x 2
4. 内蔵ネットワークポート (RJ-45)
5. シリアルポート x 1
6. インテル® HDグラフィックスからのDisplayPort (DP 1.2) 出力 x 3 (一部のプロセッサのみ)
7. PS/2ポート (キーボード、マウス)

サポートされるコンポーネント

フォームファクター スモールフォームファクター

オペレーティングシステム プリインストール:

- Windows 10 Pro 64ビット版*
- Windows 7 Professional (Windows 10 Pro 64ビット版からのダウングレード権により利用可能)**
- Windows 7 Professional 64ビット版
- HP Linux[®] -ready

サポート:

- Windows 10 Enterprise 64ビット版
- Windows 8.1 Enterprise 64ビット版
- Windows 8.1 Pro 64ビット版
- Windows 7 Enterprise 32/64ビット版
- Windows 7 Professional 32ビット版
- Red Hat[®] Enterprise Linux[®] Desktop 6、7
- SUSE Linux[®] Enterprise Desktop 11 SP3、12

*Windowsのすべてのエディションとバージョンですべての機能が利用できるわけではありません。すべてのWindows機能を活用するには、システムのアップグレード、または個別に購入するハードウェア、ドライバー、ソフトウェア、BIOSアップデートが必要になることがあります。Windows 10は自動的に更新されます。自動アップデートは常に有効になります。ISPにおける料金がかかる場合があります。その他の要件が今後追加で適用される場合があります。 <http://www.microsoft.com> を参照してください。

**本システムはWindows 7 Professionalソフトウェアがプリインストールされていますが、Windows 10 Proソフトウェア用のライセンスおよびメディアも付属しています。一度に使用できるWindowsソフトウェアのバージョンは1つ限りとなります。バージョンを切り替えるには、一方をアンインストールしてから、もう一方をインストールする必要があります。オペレーティングシステムのアンインストールおよびインストールの際にデータを失うことのないように、すべてのデータ(ファイル、写真など)をバックアップしてください。

注記: Linux[®] のOS/ハードウェアサポート情報に関する詳細は、以下をご覧ください。 http://www.hp.com/support/linux_hardware_matrix (英語)

プロセッサ

名前	コア	クロック速度 (GHz)	インテル [®] ターボ・ブースト・テクノロジー ¹	キャッシュ (MB)	メモリ速度 (MT/s)	ハイパースレディング	内蔵グラフィックス	インテル [®] vPro [®] テクノロジー搭載	TDP (W)
インテル [®] Xeon [®] プロセッサ E3-1280v5	4	3.7	4.0	8	2133	あり	なし	あり	80W
インテル [®] Xeon [®] プロセッサ E3-1270v5	4	3.6	4.0	8	2133	あり	なし	あり	80W
インテル [®] Xeon [®] プロセッサ E3-1245v5	4	3.5	3.9	8	2133	あり	インテルHDグラフィックスP530	あり	80W

サポートされるコンポーネント

インテル® Xeon® プロセッサ E3-1230v5	4	3.4	3.8	8	2133	あり	なし	あり	80W
インテル® Xeon® プロセッサ E3-1225v5	4	3.3	3.7	8	2133	なし	インテルHDグラフィックスP530	あり	80W

¹この列で示す仕様は、1つのコアがアクティブな状態での最大ターボ周波数です。ターボ・ブーストのステップは100MHzの増分で発生します。ターボ機能のないプロセッサは「なし」と表示しています。

注記:

インテル® Xeon E3、インテル® Core™ i3およびインテル® Pentium® プロセッサは、ECCまたはnon-ECCメモリのどちらもサポートします。インテル® Core™ i5/i7プロセッサはnon-ECCメモリのみをサポートします。

プロセッサナンバーは、プロセッサファミリーごとの機能を区別するものであり、プロセッサファミリーの範囲を超えるものではありません。詳細については、http://www.intel.com/products/processor_number/ (英語) を参照してください。

マルチコアは、特定のソフトウェア製品の性能向上を目的として設計されています。このテクノロジーの利用で、すべてのお客様またはソフトウェアアプリケーションにメリットがあるとは限りません。性能およびクロック周波数は、アプリケーションワークロードと、ハードウェアおよびソフトウェア構成によって変わります。インテルのナンバーは、性能の高さを示すものではありません。

色 ブラック

設置 Z240 SFFはデスクトップ上にフラットに配置するか、オプションのタワースタンドを使用してデスク上に立てることができます。

拡張スロット PCIe Gen3 x16スロット x 1本
(詳細はシステムボード PCIe Gen3 x1スロット x 1本 (x1コネクタ)
セクションを参照) PCIe Gen3 x1スロット x 1本 (x1コネクタ)
 PCIe Gen3 x4スロット x 1本 (x16コネクタ)
 M.2スロット x 1本 (PCIe Gen3 x4)*

(すべてのスロットはロープロファイル)

注記: PCIe Gen3 x16スロットでは、グラフィックスカード用に利用する場合を除き、このプラットフォーム用のAfter Market Option認定のカードのみがサポートされます。

*M.2スロットは、最大80mmまでの互換性のあるデバイスをサポートします。

拡張ベイ 共有内蔵/外部ベイ: 3.5 インチ x 1
 内蔵3.5インチベイ × 1
 内蔵2.5インチベイ × 1 (SSDのみ)

サポートされるコンポーネント

フロントI/O	USB 3.0 x 2、USB 2.0 x 1、USB 2.0チャージングデータポートx1、ヘッドフォンx1、マイク/ヘッドフォンx1。
内蔵I/O	USB 3.0ポート x 1およびUSB 2.0ポート x 2 (2つの独立した2x6 (3.0x1、2.0x1) および1x6 (2.0x1) ヘッダーとして利用可能)、HP内蔵USB 2.0ポートキット x 1およびUSB 3.0メディアカードリーダー x 1をサポート。
リアI/O	インテル® HDグラフィックスからのDisplayPort (DP 1.2) 出力 x 3 (利用できるプロセッサのみ) USB 3.0ポート x 6、シリアルポート (標準) x 1、PS/2 x 2、RJ-45 (LoM)、オーディオライン入力 x 1、オーディオライン出力 x 1。

サポートされるインターフェイス SDメディアカードリーダー (オプション)

シャーシサイズ (H x W x D)	デスクトップ (標準): 100 x 338 x 381mm (3.95 x 13.3 x 15.0 インチ) SFFタワー (オプション、スタンド寸法を除く): 338 x 100 x 381mm (13.3 x 3.95 x 15.0 インチ)
---------------------	---

重量 正確な重量は構成によって異なります。

最小重量: 5.7kg (12.66ポンド)
標準重量*: 6.7kg (14.86ポンド)
最大重量 7.7kg (16.93ポンド)

最大対応重量 (デスクトップ): 35kg (77ポンド)

*3.5インチハードドライブ x 2、オプティカルドライブ x 1、DIMM x 2、NVIDIA Quadro K620グラフィックスカード x 1 で構成した場合の通常の重量

温度	動作時: 5° ~ 35° C (40° ~ 95° F) 非動作時: -40° ~ 60° C (-40° ~ 140° F)
----	---

注記: 高度1,524m (5,000フィート) 以上における最大動作時温度は、305m (1,000フィート) の高度上昇につき1° C (1.8° F) 低下します。

湿度	動作時: 8% ~ 85% 非動作時: 8% ~ 90%
----	---------------------------------

最大高度 (非加圧)	動作時: 3,000m (10,000フィート) 非動作時: 9,100m (30,000フィート)
------------	---

電源装置	240W 92%効率のワイドレンジ、アクティブ力率補正 (PFC) 200W 85%効率のワイドレンジ、アクティブPFC電源装置オプションは一部の国で利用可能です。
------	---

240W 92%効率の電源装置に関する電源効率レポートは、以下のWebサイトにあります。未定

サポートされるコンポーネント

バックアップデバイス 互換性のあるDATテープドライブ、LTOテープドライブ、RDXリムーバブルディスクバックアップシステム製品の完全なリストについては、<http://www.hp.com/go/connect>(英語)を参照してください。

チップセット インテル® C236チップセット

メモリ DIMMスロット x 4、最大64GBのECC/non-ECC、DDR4 2133 MT/sをサポート

メモリクロックの速度はCPUが決定します。システム内で2133MT/s対応のCPUが使用されている場合、メモリの指定速度に関係なく、メモリの最大実行速度は2133MT/sになります。

注記: 最大転送速度: 2133MT/s

Workstation ISV認定 最新の認定リストについては、以下のWebサイトを参照してください。
<http://www.hp.com/united-states/campaigns/workstations/partnerships.html> (英語)

技術仕様 - システム

システムボード							
システムボードフォームファクター	ATX 24.38 x 24.38mm (9.6 x 9.6インチ)						
プロセッサソケット	シングルLGA1151						
CPUバス速度	DMI						
チップセット	インテル® PCH C236						
メモリ拡張スロット	DDR4メモリスロット x 4						
サポートするメモリタイプ	DDR4、UDIMM (バッファなし)、ECC						
メモリモード	シングルチャンネルではノンインターリーブ。両方のチャンネルが設定されている場合はインターリーブ。						
サポートするメモリ速度	2133MT/s DDR4						
メモリ保護	データでECCが利用可能						
最大メモリ	64GB						
メモリ構成 (サポート)	4GB、8GBおよび16GB ECC Unbuffered DIMMをサポート。 同一システムにECCメモリDIMMとnon-ECCメモリDIMMの混在不可。 注記: * 最大メモリ容量は、Windows® 7 Professional 64ビット版またはRed Hat® Linux® 64ビット版などの64ビットオペレーティングシステムを前提としています。32ビット版Windowsオペレーティングシステムは最大4GBまでサポートします。						
PCI Expressコネクタ	<ul style="list-style-type: none"> • PCI Express Gen3スロット x 1本 (x16メカニカル、x16電気的。LP、ハーフフレングス) • PCI Express Gen3スロット x 1本 (x1メカニカル、x1電気的。LP、ハーフフレングス) • PCI Express Gen3スロット x 1本 (x1メカニカル、x1電気的。LP、ハーフフレングス) • PCI Express Gen3スロット x 1本 (x16メカニカル、x4電気的。LP、ハーフフレングス) • M.2スロット x 1本 (PCIe Gen3 x4)¹ <p>注記: LP = ロープロファイル</p> <p>注記: PCIe Gen3 (x16電気的、x16メカニカル) スロットでは、グラフィックスカード用に利用する場合を除き、このプラットフォーム用のAfter Market Option認定のカードのみがサポートされます。</p> <p>注記1: M.2スロットは、最大80mmまでの互換性のあるデバイスをサポートします。</p>						
サポートされるドライブインターフェイス	<table border="1"> <tr> <td>SATA</td> <td>Serial ATA内蔵インターフェイス x 4 (6Gb/s SATA)。RAID 0、RAID 1対応 (工場組み込みのRAIDはMicrosoft Windowsのみ)</td> </tr> <tr> <td>Serial Attached SCSI</td> <td>サポートしません。</td> </tr> <tr> <td>内蔵RAID</td> <td>注記: (速度、容量、インターフェイスが) 同一のハードドライブが必要です。</td> </tr> </table>	SATA	Serial ATA内蔵インターフェイス x 4 (6Gb/s SATA)。RAID 0、RAID 1対応 (工場組み込みのRAIDはMicrosoft Windowsのみ)	Serial Attached SCSI	サポートしません。	内蔵RAID	注記: (速度、容量、インターフェイスが) 同一のハードドライブが必要です。
SATA	Serial ATA内蔵インターフェイス x 4 (6Gb/s SATA)。RAID 0、RAID 1対応 (工場組み込みのRAIDはMicrosoft Windowsのみ)						
Serial Attached SCSI	サポートしません。						
内蔵RAID	注記: (速度、容量、インターフェイスが) 同一のハードドライブが必要です。						

技術仕様 - システム

	内蔵グラフィックス	<p>インテルHDグラフィックス530 (Core i3/i5/i7-6xxxプロセッサ)、 インテル内蔵型グラフィックス (Xeon E3プロセッサ対応)</p> <p>UMA (Unified Memory Architecture) をベースとし、システムメモリの一部がグラフィックス用に割り当てられる。 インテル® HDグラフィックスP530上でMicrosoft® Direct X 11、OpenGL 4.0およびOpenCL 1.2のサポート。</p> <p>DP 1.2x3 グラフィックスポート (マザーボードに内蔵)、 DP出力を使って最大3台の同時ディスプレイ可能。 サポートされる最大解像度: 3840x2160 @60Hz</p>	
	ネットワークコントローラー	内蔵Ethernet PHY接続I219LM。 管理機能: WOL、PXE 2.1、AMT 11.0	
	IDEコネクタ	なし	
	フロッピーコネクタ	なし	
	シリアルポート	リア x1	
	セカンドシリアルポート	あり (オプションのシリアルアダプターキットが必要)	
	パラレル	内部ヘッダー x1 (オプションのパラレルポートアダプターが必要)	
	IEEE 1394コネクタ		
	USBコネクタ	<p>フロント</p> <p>リア</p> <p>内蔵</p>	<p>USB 3.0 x 2、USB 2.0 x 2</p> <p>USB 3.0 x 6</p> <p>USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 2</p>
	HD内蔵オーディオ	あり	
	フラッシュROM	あり	
	シャーシファンヘッダー	なし	
	フロントコントロールパネル/スピーカーヘッダー	あり	
	CMOSバッテリーホルダー - リチウム製	あり	
	内蔵TPM (Trusted Platform Module)	内蔵TPM 1.2	
	電源ヘッダー	あり	
	電源スイッチ/電源LED/ハードドライブLEDヘッダー	あり	
	パスワードクリアジャンパー	あり	
	キーボード/マウス	USBまたはPS/2	

技術仕様 - システム

	240W、92%電源効率、ワイドレンジ、アクティブPFC電源装置 (注記: 200W 85%効率のワイドレンジ、アクティブPFC電源装置オプションは一部の国で利用可能です。) Z240 SFF 92% PSU効率レポートは、以下のリンクで閲覧できます。未定
動作時電圧範囲	90 ~ 264VAC
定格電圧範囲	100 ~ 240VAC
定格入力周波数	50 ~ 60Hz
動作時入力周波数範囲	47 ~ 63Hz
定格入力電流	4A @ 100 ~ 240V
放熱	通常時: 112kcal/時 (444BTU/時) 最大値: 224kcal/時 (890BTU/時)
電源ファン	70mm x 70mm x 25mm 4ワイヤーPWM
ENERGY STAR® 準拠 (構成によって異なる)	あり
FEMP Standby Power準拠	あり、Wake-on LAN無効: S5 (電源オフ時) で2W未満
耐サージ電源 (最大2,000V)	あり
ErP Lot 6- Tier 2準拠、230V (S5 (電源オフ時) で0.5W未満)	あり

公示ノイズ (エントリレベル構成/ハイエンド構成)

システム構成 (エントリレベル)	プロセッサ情報	
	メモリ情報	
	グラフィックス情報	
	ディスク/光学ドライブ	
システム構成 (ハイエンド)	プロセッサ情報	
	メモリ情報	
	グラフィックス情報	
	ディスク/光学ドライブ	

環境要件	温度	動作時: 5° ~ 35° C (40° ~ 95° F) 非動作時: -40° ~ 60° C (-40° ~ 140° F)
	湿度	動作時: 相対湿度8% ~ 85%、結露しないこと 非動作時: 相対湿度8% ~ 90%、結露しないこと
	最大高度	動作時: 3,000m (10,000フィート) 非動作時: 9,100m (30,000フィート)
	動的特性 (新規)	耐衝撃 動作時: ½サイン: 40g、2 ~ 3ms

技術仕様 - システム

		<p>非動作時: ½サイン: 160cm/秒、2 ~ 3ms (最大100g) 四角形: 422cm/秒、20g</p> <p>振動 動作時 (ランダム): 0.5g (rms)、5 ~ 300Hz 非動作時 (ランダム): 2.0g (rms)、10 ~ 500Hz</p> <p>注記: 値は個別の衝撃を表すもので、繰り返し衝撃を示すものではありません。値は連続的な振動を示すものではありません。</p>
	冷却	<p>高度1,524m (5,000フィート) 以上における最大動作時温度は、305m (1,000フィート) の高度上昇につき1° C (1.8° F) 低下します。</p>

物理セキュリティおよび保守性

アクセスパネル	ツールレス システムボードおよびメモリ情報を含む
ハードドライブ	ツールレス (内蔵ベイ)
拡張カード	ツールレス
プロセッサソケット	ツールレス (プロセッサヒートシンクを除く)
ユーザータッチポイント (緑)	あり。ツールフリー、シャーシ内蔵機構。
色つきケーブル/コネクタ	あり
メモリ	ツールレス
システムボード	ねじ込み式
コンピューター前面のデュアルカラー電源/HD LED	あり
構成記録ソフトウェア	あり
画面上での温度警告	あり
リストメディアセット	オペレーティングシステムDVD (OSDVD) およびドライバーDVD (DRDVD) で構成。OSDVDは出荷時のオペレーティングシステムを復元します。DRDVDはシステムのすべてのドライバーを提供します。DRDVDには、オプションでインストールするための、システムとともに出荷されるアプリケーションが含まれる場合があります。アプリケーションはHP.comでも入手できます。OSVDとDRDVDはシステムとともに注文でき、HP Supportでも入手可能です。
デュアル機能のフロント電源スイッチ	あり。4秒押し続けると、フェイルセーフな電源切断を実施します。
施錠サポート	あり (オプション): サイドカバーをロックし、シャーシの盗難を予防します。システム背面に直径0.22インチの施錠用ループ
ケーブルロックサポート	あり。ケンジントン社製ロック (オプション): サイドカバーをロックし、シャーシの盗難を予防します。システム背面に3mm x 7mmスロット

技術仕様 - システム

ユニバーサルシャーシ クランプ施錠サポート	あり (オプション): サイドカバーをロックし、ケーブルをシャーシに固定。シャーシの盗難を防ぎます。オプションのケーブルを使用すれば、複数のユニットをまとめて施錠できます。 システム背面にねじ付き
スマートカバーロック/ フードセンサー	あり (オプション) ソレノイドフードロックは、ソフトウェアとパスワードでシャーシをロックできるため、物理的なキーは必要ありません。ネットワークを経由してシャーシをリモートでロック、またはロック解除できます。センサーキットは、アクセスパネルの取り外しを検出します。
リアポートコントロール カバー	あり。背面のI/Oケーブルをロックし、盗難を防止します。
シリアル/パラレル/USB/ オーディオ/ネットワーク ポートの有効化/無効 化の管理	あり。シリアル/パラレル/USB/オーディオ/ネットワークポートの有効/無効を設定します。
リムーバブルメディア の書き込み/起動制御	あり。サポートするデバイス上で、リムーバブルメディアからの起動機能を停止します (メディアへの書き込みの無効化も可能)。
電源投入時パスワード	あり。権限を与えられていない人物によるワークステーションの起動を阻止します。
セットアップパスワード	あり。権限を与えられていない人物によるワークステーションの構成変更を阻止します。
NIC LED (内蔵) (緑/黄)	あり
CPU/ヒートシンク	CPUを取り外すには、CPUヒートシンクをT-15トルクドライバーまたはマイナスドライバーで取り外す必要があります。CPUの取り外しには、ツールは必要ありません。
電源診断LED	なし
電源ボタン (フロント)	あり。ACPIマルチ機能
電源LED (フロント)	あり。白 (正常)、赤 (障害)
ハードドライブ動作LED (フロント)	あり。白
ODD動作LED (フロント)	あり
内蔵スピーカー	あり
システム/緊急ROMフラ ッシュリカバリ	破損したシステムBIOSを復元します。
冷却ソリューション	空冷式の対流冷却
電源ファン	70mm x 70mm x 25mm 4ワイヤーPWM (サービス不可)
CPUヒートシンクファン	主流 (<=65W): 93mm x 86mm x 75.8mm 高性能 (<=95W): 93mm x 102.7mm x 75.8mm
シャーシファン	なし。CPUヒートシンクファンはシャーシファンとしても機能します。
メモリヒートシンクフ ァン	なし
HP PCハードウェア診断 UEFI	HP PCハードウェア診断 (UEFI) により、オペレーティングシステム外で多くのコンポーネントのハードウェアテストを実行できます。診断はPOST実行時にF2を押して起動でき、HP Supportからダウンロードできます。

技術仕様 - システム

アクセスパネルキーロック	なし
ACPI対応ハードウェア	ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) <ul style="list-style-type: none"> システムを省電力モードから復帰させます。 システムの電力消費を制御します。システムのその他の要素に影響を与えることなく、各種カードや周辺機器を省電力モード、または電源オフの状態にできます。
TPM (Trusted Platform Module) チップ	あり
内蔵シャーシハンドル	なし
電源装置	T15トルクドライバーまたはマイナスドライバーが必要
PCIカード固定	あり。リア(すべて)、ミドル(なし)、フロント(なし)
フラッシュROM	あり
ボード上の診断電源スイッチLED	あり
パスワードクリアジャンパー	あり
CMOSクリアボタン	あり
CMOSバッテリーホルダー	あり
DIMMコネクター	あり

技術仕様 - システム

BIOS	
BIOS 32ビットサービス	標準BIOS 32ビットサービスディレクトリ提案v0.4
PCI 3.0サポート	業界標準インターフェイスによるPCI ExpressのBIOSフルサポート
ATAPI	ATAPIリムーバブルメディアデバイスBIOS仕様バージョン1.0
BBS	BIOSブート仕様v1.01. ワークステーション起動時のデバイス制御を向上します。
WMIサポート	WMIはMicrosoftが提供するWindows用のWBEM (Web-Based Enterprise Management) です。WMIはDMTF (Distributed Management Task Force) 仕様、CIM (Common Information Model) 仕様、およびWBEM 仕様に完全準拠しています。
BIOS電源投入	システムを起動する特定の日時を設定できます。
ROMベースコンピューターセットアップユーティリティ (F10)	BIOSが制御するシステム構成設定を表示およびカスタマイズします。
ビデオによるシステム/緊急ROMフラッシュリカバリ	破損したフラッシュROMからシステムBIOSを復元します。
リプリケートセットアップ機能	USBフラッシュデバイスの読み取り可能なファイルにBIOS設定を保存します。Repset.exeユーティリティはこれらの設定をマシン上で展開して複製するため、Computer Configuration Utility (F10 セットアップ) で入力する必要はありません。
SMBIOS	System Management BIOS 2.7.1 (システム管理情報向け)
起動制御	サポートするデバイス上で、リムーバブルメディアからの起動を無効にします。
メモリ変更アラート	メモリを取り外し、または変更した場合に、管理コンソールに通知します。
温度アラート	シャーシ内の温度状態を監視します。次の3つのモードがあります。 <ul style="list-style-type: none"> • NORMAL - 通常の温度範囲 • ALERTED - 温度過剰を検出した場合。シャットダウンを回避、またはスムーズなシステムのシャットダウンが行えるよう警告します。 • SHUTDOWN - 温度過剰が発生した場合。ハードウェアの損傷が発生する前に、コンピューターを自動的にシャットダウンします。
リモートROMフラッシュ	中央のネットワークコンソールから、セキュアかつ確実なROMイメージ管理が行えます。OSを起動する前にアップデートを実行できます。アップデートのスケジュール設定が可能です。
ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)	システムで省電力モード (スリープ状態) への移行、または省電力モードからの復帰を行えるようにします。 オペレーティングシステムが動的負荷に応じて、システムの電力消費を制御できるようにします。 システムのその他の要素に影響を与えることなく、各種カードや周辺機器を省電力モード、または電源オフの状態にできます。 ACPI 4.0をサポートしており、64ビットのオペレーティングシステムと完全な互換性があります。
オーナーシップタグ	BIOSスプラッシュ画面に表示される、不揮発性メモリに保存されたユーザー定義の文字列。
リモートウェイクアップ/リモートシャットダウン	システム管理者がリモート拠点からクライアントコンピューターの電源投入、再起動、電源切断を行えます。
ASF 2.0準拠	なし

技術仕様 - システム

Instantly Available PC (Suspend to RAM - ACPIスリープ状態S3)	クイックレジューム時の超低電力消費を実現します。
F12でのシステムリモートインストール (PXE 2.1) (サーバーからのリモート起動)	ネットワーク経由で新規または既存のシステムを起動し、オペレーティングシステムなどのソフトウェアをダウンロードできます。
ROMリビジョンレベル	Computer Configuration Utility (F10セットアップ) でシステムBIOSリビジョンレベルを報告します。バージョンは業界標準インターフェイス (SMBIOS) で提供されるため、管理ソフトウェアアプリケーションはこの情報を利用して報告を行います。
システムボードリビジョンレベル	管理ソフトウェアでシステムボードのリビジョンレベルを読み取ることができます。リビジョンレベルはハードウェアにデジタルエンコードされるため、変更できません。
スタートアップ診断 (電源投入時セルフテスト)	起動時に所定のテストを行い、システムの状態を評価します。
新規ハードウェア導入時の自動セットアップ	新しいハードウェアの追加をシステムが自動検出します。
キーボードレス操作	キーボードを使わずにシステムを起動できます。
ローカライズされたROMセットアップ	共通のBIOSイメージでは、ローカルキーボード配置を利用した、Computer Configuration Utility (F10セットアップ) の12ヶ国語のメニューに対応します。
資産タグ	ユーザーまたはIT管理者は、不揮発性メモリに独自のタグ文字列を設定できます。
スロットごとの制御	I/Oスロットパラメーター (オプションROMの有効化/無効化) を個別に設定できます。
適応型冷却	検出されたハードウェア構成に応じて制御パラメーターを設定し、音響を最適化します。
起動前診断	早期段階 (プレビデオ) の重大なエラーをビープ音または電源LEDの点滅で報告します。
インテル® AMT (Active Management Technology)	AMT 11.0では、リモートコンソール上でワークステーションのステータスが監視できます。
デジタル処理と暗号化で署名されたBIOS	ウィルスやマルウェアなどのコードはシステムセキュリティ、データアクセス、物理サービス、さらにはシステムボードの交換を危険にさらすことにつながります。これらから不正なBIOS (危険なBIOS) がインストールされるのを防ぎます。
マスターブートレコードの保護	マスターブートレコードの改ざんやウィルス感染を防ぐHP BIOSの機能。ウィルスからの保護に有用です。
ブートブロック緊急復旧モード (BIOSリカバリ)	HP BIOSでは書き込み禁止のブートブロックROMが用意され、コンピューターBIOSのフラッシュが失敗した際のリカバリが可能です。この特別な復旧モードは、BIOSアップデートが中断したときに、システムが使用できなくなる (「ブリックする」) のを防ぎます。
業界標準仕様サポート	
業界標準	BIOSがサポートするリビジョン
UEFI仕様のリビジョン	UEFI 2.4.0
ACPI	ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)、バージョン4.0
ASF	ASF (Alert Standard Format) 仕様、バージョン2.0
ATA (IDE)	ATA/ATAPI-6 (AT Attachment 6 with Packet Interface)、リビジョン3b
CD起動	"El Torrito"起動可能CD-ROMフォーマット仕様 (Bootable CD-ROM Format Specification) バージョン1.0
EDD	- 拡張ディスクドライブ仕様 (Enhanced Disk Drive Specification) バージョン1.1 - BIOS拡張ディスクドライブ仕様 (Enhanced Disk Drive Specification) バージョン3.0
PCI Express	PCI Express基本仕様 (PCI Express Base Specification)、リビジョン2.0

技術仕様 - システム

	PCI Express基本仕様 (PCI Express Base Specification)、リビジョン3.0
PMM	POSTメモリアネージャ仕様 (Memory Manager Specification)、バージョン1.01
SATA	- Serial ATA仕様、リビジョン1.0a - Serial ATA II: Serial ATA 1.0に関する拡張、リビジョン1.0a - Serial ATA IIケーブルおよびコネクタ、ボリューム2 GOLD - SATA-I/O SATAリビジョン3.0仕様
SPD	PC SDRAM SPD (Serial Presence Detect) 仕様、リビジョン1.2B
TPM	Trusted Computing Group TPM仕様、バージョン1.2 (ファームウェアアップデートによりTPM 2.0)
USB	USBリビジョン1.1仕様 (Universal Serial Bus Revision 1.1 Specification) USBリビジョン2.0仕様 (Universal Serial Bus Revision 2.0 Specification) USBリビジョン3.0仕様 (Universal Serial Bus Revision 3.0 Specification)

社会的/環境的責任

エコラベル認定/宣言	<p>本製品は、電源コード、ケーブル、周辺機器を除き、低ハロゲンとなっています。ご購入後に入手したサービス部品は低ハロゲンではない可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ENERGY STAR® (特定の構成で省エネルギー機能が利用できます - Windowsのみ) US Federal Energy Management Program (FEMP) 中国エネルギー保存計画 (CECP) IT ECO宣言
バッテリー	<p>本製品内のバッテリーはEU指令2006/66/ECに準拠しています。 バッテリーサイズ: CR2032 (コイン電池) バッテリータイプ: リチウム金属</p> <p>製品内のバッテリーには以下の物質は含まれていません。</p> <ul style="list-style-type: none"> 5ppmを超える水銀 10ppmを超えるカドミウム 40ppmを超える鉛
規制物質の使用	<p>本製品に含まれる物質で、HP General Specification for the Environmentに指定された規制値を超えるものは一切ありません。以下のWebサイトを参照してください。 http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/gse.pdf (英語)</p> <p>HPはRoHS (European Union Restriction of Hazardous Substances) 指令をはじめとする、該当するすべての法規制に準拠しています。HPでは、RoHS指令の要件に世界規模で適応することで、必須とされるコンプライアンス準拠のレベルを超えることを目標としています。</p>
低ハロゲンに関する声明	<p>本製品は、電源コード、ケーブル、周辺機器、ならびにお客様が構成可能な以下の内部コンポーネントを除き、低ハロゲンとなっています。Creative Recon3D PCIeオーディオカードは低ハロゲンではありません。ご購入後に入手したサービス部品は低ハロゲンではない可能性があります。</p>
使用済み製品の管理とリサイクル	<p>HPでは、多くの地域で使用済みHP製品の返却/リサイクルプログラムを実施しています。製品をリサイクルするには、 http://www.hp.com/recycle (英語) を参照するか、またはお近くのHP販売店までお問い合わせください。HPに返却された製品は、しかるべき方法でリサイクル、再生、または廃棄されます。本製品は、使用終了時に正しく廃棄すれば、重量パーセントで90%以上がリサイクル可能です。</p>
HPの環境情報	<p>HPの環境に対する取り組みについては、以下をご覧ください。</p>

技術仕様 - システム

	<p>Living Progressレポート:http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/qcreport/index.html (英語)</p> <p>エコラベル認定:http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/ecolabels.html (英語)</p> <p>ISO 14001認定: http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/operations/envmanagement.html (英語)</p>
その他の情報	<ul style="list-style-type: none"> ● 本製品は、WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) - 2002/96/EC指令に準拠するように設計されています。 ● 本製品で使用する、25グラムを超えるプラスチック部品は、ISO 11469およびISO 1043に従ってマーキングされています。 ● 本製品は、使用終了時に正しく廃棄すれば、90%以上がリサイクル可能です。 ● 米国EPEATで登録されているEPEAT Gold登録は、国によって異なります。国別の登録ステータスについては、www.epeat.net (英語) をご確認ください。
パッケージ	<p>HPワークステーション製品のパッケージは、「HP General Specification for the Environment」 (http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/society/gen_specifications.html(英語)) に従っています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● HP標準011-1 General Specification for the Environment (上記リンクを参照) に記載された規制物質を使用しない。 ● オゾン破壊物質 (ODS) を使用しない。 ● 重金属 (鉛、水銀、または六価クロム) について、これらすべての合計が100ppmを超えない。 ● パッケージ材料で、使用済みリサイクル材料を最大限活用する。 ● すべてのパッケージ材料がリサイクル可能である。 ● すべてのパッケージ材料が解体しやすいようデザインされている。 ● 輸送時の燃料効率が向上するよう、パッケージのサイズや重量を低減する。 ● プラスチック製のパッケージ素材は、ISO 11469およびDIN 6120標準に従ってマーキングする。
パッケージ材料	
内部	クッション材は、発泡ポリエチレン (EPE) または発泡ポリプロピレン (EPP) のリサイクル材で作られています。また、リサイクルされたモールド紙パルプ (MPP) で作られる場合もあります。
外部	段ボールから作られるカートンには25%以上のリサイクル材が含まれています。

管理容易性

インテル® AMT (Active Management Technology)	<p>システムの稼働状況または電源状態にかかわらず、ネットワーククライアントシステムをリモートで検出、回復、保護するための最新で最も効率的なツールをネットワーク管理者に提供する、高度なリモート管理機能セット。AMT 11.0には以下の高度な管理機能が含まれています。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電源管理 (オン、オフ、スタンバイ、リセット) ● ハードウェア/ソフトウェアインベントリ (BIOSおよびファームウェアリビジョンを含む) ● ハードウェアアラート ● エージェントプレゼンス ● システムディフェンスフィルター ● SOL (Serial Over LAN) ● ME Wake-on-LAN ● DASH 1.1準拠
--	--

技術仕様 - システム

	<ul style="list-style-type: none"> • IPv6サポート • Fast Call for Help - ファイアウォールの内側または外側のクライアントが、BIOS画面、定期的な接続、またはアラートトリガー接続を使用してヘルプコールを開始できます。 • Remote Scheduled Maintenance - メンテナンスのためにPCをITまたはサービスプロバイダーのコンソールに接続するタイミングを事前にスケジュールします。都合のよいときに、リモートPCをITコンソールまたはサービスプロバイダーに接続することで、必要なパッチの取得や、インベントリ登録ができます。 • Remote Alerts - 問題の発生時にITまたはサービスプロバイダーに自動的にアラートを送ります。 • Access Monitor - インテル® AMTの動作を監視し、セキュリティ要件をサポートします。 • PCアラームクロック • Protected Audio Video Path (PAVP) • Microsoft NAPサポート • ホストベースのセットアップ/構成 • ME (Management Engine) ファームウェアのロールバック • KVM解像度の向上 (最大4K)
インテル® vPro® テクノロジー	<p>次に示すvPro® テクノロジー対応のCPUを購入された場合、HP Z240 Workstationはインテル® vPro® テクノロジーをサポートします。インテル® VT-d/VT-xおよびインテル® TXTテクノロジー搭載の、インテル® Xeon® プロセッサファミリまたは第6世代インテル® Core i5/i7プロセッサ。</p>
リモート管理容易性ソフトウェアソリューション	<p>詳細については、 http://www.hp.com/go/easydeploy (英語) をご覧ください。</p>
System Software Manager	<p>詳細については、 http://www.hp.com/go/ssm (英語) をご覧ください。</p>
サービス/サポート/保証	<ul style="list-style-type: none"> • ユーザーが定義したプロファイルを元に、製品変更通知 (PCN: Product Change Notification) および技術サポート (Customer Advisories) 情報を電子メールで事前にユーザーに通知するプログラムです。 • PCNにより、工場内で実装されるハードウェアやソフトウェアの変更が事前に通知されるため、移行を計画する時間を確保できます。 • 技術情報には、効果的な問題解決情報が簡潔に示されており、テクニカルサポートに連絡する手間が大幅に減ります。

HPでは、HP Workstationのお客様向けに、ハードウェア、ソフトウェア、ソリューションのイノベーションへの取り組みの一環として、この画期的なプラットフォーム構成の安定性をご紹介します。「HP Stable & Consistent Offerings」は、すべてのHP Z Workstationプラットフォームで使用期限まで機能するように設計およびテストされた一連のハードウェアおよびソフトウェアを慎重に選択し、それらを基盤として構築されています。このセクションでは、これらのコンポーネントとこれに対応するHP Workstationプラットフォームの互換性について概説します。

「HP Stable & Consistent Offerings」は、HP Workstationのすべてのお客様に世界中どこでもご利用いただけます。特別なプログラムや追加のコストは一切必要ありません。HP Workstationをカスタマイズするときにハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントを選択するだけで、製品のライフサイクルを通じて同じ構成が購入できるように保証されます。

その他オプション製品の技術仕様については下記のQuickSpecs（英語版）をご参照ください。

<http://h18000.www1.hp.com/products/quickspecs/productbulletin.html#ispectype=worldwide>

© 2015 HP Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein. Intel, Intel Core, Pentium, Thunderbolt and Xeon are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. AMD is a trademark of Advanced Micro Devices, Inc. ENERGY STAR[®] is a registered trademark owned by the U.S. Environmental Protection Agency. Linux[®] is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. NVIDIA[®], NVS and Quadro and the NVIDIA logo are trademarks and/or registered trademarks of NVIDIA Corporation in the U.S. and other countries. Red Hat[®] is a registered trademark of Red Hat, Inc. in the United States and other countries. SD is a trademark or registered trademark of SD-3C in the United States, other countries or both. Bluetooth is a trademark of its proprietor used by Hewlett Packard Company under license.
